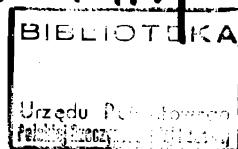


Warszawa, 20 kwietnia 1938 r.

URZĄD PATENTOWY

A01n 17/02²

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26207.

Kl. ~~45-1, 3~~ 701.

45 l 17/02

Maria Schoene
(Warszawa, Polska).

Sposób tępienia szkodników tytoniowych za pomocą chloropikryny.

Patent dodatkowy do patentu Nr 20940.

Zgłoszono 21 marca 1936 r.

Udzielono 16 lutego 1938 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do dnia 11 stycznia 1950 r.

Znane są sposoby niszczenia szkodników roślinnych za pomocą chloropikryny. Sposób tępienia szkodników tytoniowych za pomocą chloropikryny jest opisany w patencie nr 20 940, według którego odparowuje się względnie rozpyla roztwór chloropikryny w rozpuszczalniku bardziej od niej lotnym lub w mieszaninie takich rozpuszczalników.

Przy bliższym badaniu działania chloropikryny na szkodniki roślinne surowca tytoniowego spostrzeżono, że można stosować ze znacznie lepszym skutkiem odparowywanie lub rozpylanie roztworu chloropikryny w pomieszczeniu zawierającym surowiec

tytoniowy, jeżeli temperatura otoczenia wynosi od 20 do 35°C, przy czym względna wilgotność powietrza jednocześnie wynosi około 90%. Temperatura powyżej 35°, jakkolwiek sprzyjałaby łatwiejszej dyfuzji, byłaby jednakże szkodliwa ze względu na nadmierne wysuszenie tytoniu.

Zauważono dalej, że skuteczniejsze działanie uzyskuje się, jeżeli strumień rozpylanego lub odparowywanego roztworu chloropikryny w powyższych warunkach pracy kieruje się nie bezpośrednio na sam odkażany materiał tytoniowy, lecz na ściany i pułap względnie sufit pomieszczenia, w którym znajduje się ten materiał.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Sposób tępienia szkodników tytoniowych za pomocą chloropikryny według patentu nr 20 940, znamienny tym, że odkazywanie roztworem chloropikryny przeprowadza się w pomieszczeniu, zawierającym odkazywany materiał, w temperaturze otoczenia od 20 do 35°C przy jednoczesnej względnej wilgotności powietrza około 90%.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny

tym, że strumień rozpylanego lub odparowywanego roztworu chloropikryny kieruje się nie bezpośrednio na materiał odkazywany, lecz na ściany i pułap względnie sufit pomieszczenia zawierającego odkazywany materiał.

M a r i a S c h o e n e.

Zastępca: Inż. W. Tymowski,
rzecznik patentowy.